
글로벌 AI 데이터센터 산업동향 조사를 위한 COMPUTEX TAIPEI 2026 참관

국외출장 결과보고

- '26. 6. 1.(월) ~ 6. 5.(금), 대만(타이베이) -

2026. 06.

1

출장 개요

□ 추진 배경

- AI 혁신 가속화, AI 주도권 확보 등 글로벌 AI 경쟁이 심화되며, 데이터센터는 국가 성장의 기반이 되는 인프라로 중요성이 갈수록 증가
 - 글로벌 주요국은 데이터센터를 핵심 국가 기반 시설로 지정하고 다양한 정책 지원 등을 통해 데이터센터 유치·구축을 확대
- ※ 미국은 세계 최대 AI 컴퓨팅 클러스터 구축을 위한 5,000억 달러(약 700조원) 규모의 '스타게이트(Stargate) 프로젝트'를 추진 중이며 데이터센터 건설 허가 등 신속 처리 지원
- 글로벌 AI 데이터센터 산업동향 파악 및 AI 데이터센터 신사업 발굴을 통한 국내 산업에 적용·확산을 위해 COMPUTEX 2026 참가

대만 COMPUTEX 2026 행사 개요

- **행 사 명 : COMPUTEX TAIPEI 2026**
 - * 중화민국대외무역발전협회(TAITRA), 타이페이컴퓨터협회(TCA) 공동주최
- **일시/장소 :** 2026. 6. 2.(화) ~ 6. 5.(금) / 대만 Taipei Nangang Exhibition Center
- **참가규모 :** 참가기업 1,400개, 4,800개 부스, 참관객 80,000여명 등
- **전시카테고리 :** AI & Computing, Robotics & Mobility, Next-Gen Tech, Sustainable Innovation

□ 출장일정 : 2026. 6. 1.(월) ~ 6. 5.(금), 4박 5일

□ 출장지 : 대만 타이베이

□ 출장자 및 주요업무

성 명	출장기간	주요업무
정은주 수석 손예지 책임	6.1.(월) ~ 6.5.(금) (4박 5일)	- 글로벌 AIDC 기업 전시관 방문, 주요 전략 분석 및 산업동향 조사

□ 주요 활동 내용

- 주요 컨퍼런스 및 부대행사에 참여하여 AI 데이터센터 관련 주요 기술 트렌드, 시장 전망, 기업별 기술 전략 정보 수집
- 전시관 참관 및 참가기업 교류를 통해 AI 데이터산업 현황을 파악하고, 우리 원 사업과 협업 및 개선 방안 발굴 등 네트워크 강화

□ 세부 일정

일 정		방문지역	내용
1일차	6.1(월)	인천(ICN)- 타오위안(TPE)	• 인천출발 13:55 → 타오위안 도착 15:30 • COMPUTEX 2026 동선 및 참가기업 리스트 등 사전점검
2일차	6.2(화)	타오위안(TPE)	• COMPUTEX 2026 행사 참관(1일차) - 기조연설 참석 * 오전 : Marvell Tech(DC), NVIDIA(AI 생태계&Physical AI) * 오후 : Qualcomm(Edge AI), Intel(Next-Gen Computing ST) • 참가기업 협력 회의
3일차	6.3(수)		• COMPUTEX 2026 행사 참관
4일차	6.4(목)		• COMPUTEX 2026 행사 참관 • 참가기업 협력 회의
5일차	6.5(금)	타오위안(TPE)- 인천(ICN)	• 타오위안 출발 12:25 → 인천 도착 15:55

2 주요 내용

□ 개요

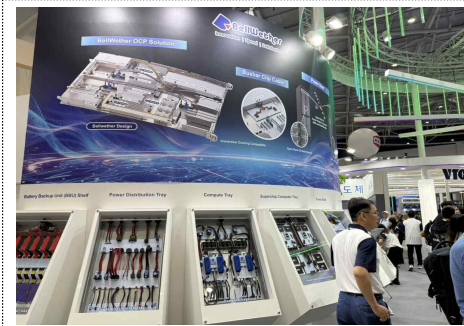
- COMPUTEX 2026은 ‘AI 팩토리(AI Factory)’ 로의 데이터센터 진화와 이를 위한 초고밀도 인프라의 통합 솔루션을 핵심 테마로 제시
 - 글로벌 기업들은 에이전틱 · 물리적 AI 워크로드 처리를 위한 랙 스케일(Rackscale) 인프라, 고전압 · 고전력 아키텍처, 차세대 직접 액체냉각(DLC) 기술 등 핵심 전력 · 열관리 솔루션 대거 공개

< COMPUTEX 2026 기조연설 AI 데이터센터 관련 내용 >

- **(엔비디아 CEO, Jensen Huang)** 데이터센터는 전력을 소모해 고가치의 지능을 생산하는 진정한 AI 팩토리로 완전히 재정의되고 있음
- **(퀄컴 CEO, Cristiano Amon)** 앞으로 마주할 고도화된 AI 에이전트 워크로드들은 클라우드가 담당하는 '하이브리드 AI 컴퓨팅' 인프라로의 전환이 필수적
- **(인텔 CEO, Lip-Bu Tan)** '30년까지 AI 추론 워크로드가 전체 데이터센터 전력 수요의 약 40%를 차지할 것으로 전망, 에이전틱 AI 구동을 위해서는 전력 효율적 아키텍처로의 대전환 필요
- **(마벨테크놀로지 CEO, Matt Murphy)** AI DC 인프라의 성능 향상과 스케일업의 성패는 반도체와 시스템을 얼마나 촘촘하고 빠르게 연결하는가, '연결성'에 달려 있음

□ 전시 주요내용

① AI Server ODM / Rack Integration

기업명	주요내용
ACER (대만)	- 글로벌 ICT 기업으로서 Acer 본사는 AI PC 비중이 크며, 그룹사 Altos Computing이 AI 서버·HPC·인프라 영역을 담당 - 자회사 Altos를 통해 고밀도 폼팩터 기반의 AI 서버 및 HPC 인프라 솔루션을 전개. 한정된 공간 내에 다중 컴퓨트 노드와 고성능 GPU 및 대용량 ECC 메모리를 집적하는 서버 아키텍처를 제시  
Bellwether (대만)	- 커넥터, 케이블, Pogo, FPCA, 금속사출 부품 등을 설계·생산하는 대만 전자부품 기업으로, AI 서버용 커넥터/배선류 공급 - AI 서버 및 데이터센터 인프라용 초고속 커넥터, 고전류 배선류 (케이블링 시스템) 등 고신뢰성 인터커넥트 부품 공급망 전시  
Inventec (英業達集團) (대만)	- 서버, 노트북, 엔터프라이즈 장비를 생산하는 대만 ODM/전자제조 그룹으로 AI 인프라와 Physical AI 사업 확장중 - 차세대 GPU 아키텍처 기반의 엣지 AI 서버와 Physical AI 인프라 솔루션 공개, 대규모 생성형 AI 모델을 엣지에서 직접 구동할 수 있는 고성능 컴퓨팅 구조 제시  

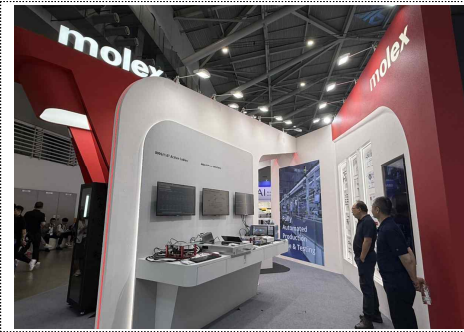
기업명	주요내용
ASRock Rack (대만)	- 클라우드·서버·AI 인프라용 서버 하드웨어를 개발하는 대만 서버 전문 기업 - NVIDIA 차세대 플랫폼 기반의 액체냉각 랙 솔루션 및 다양한 폼 팩터의 DLC(Direct Liquid Cooling) 서버 라인업 공개. 복잡한 에이전틱 및 강화학습 워크로드를 가속화하는 최적화 구조 제시  
MiTAC (대만)	- AI/HPC/클라우드용 서버·랙·클러스터 솔루션을 제공하는 대만계 컴퓨팅 인프라 업체 - 고밀도 액체냉각 랙 시스템, 다중 GPU 가속 서버 및 모듈형 데이터센터 솔루션 제공. 공랭 한계를 극복한 고효율 냉각 구조를 통해 고온의 흡기 조건에서도 안정적인 토큰 생성 성능 제시 * 표준 대비 랙당 GPU 밀도 50% 향상, 기존 대비 최대 50% 많은 토큰 생성 가능  

② GPU / AI Compute Core

기업명	주요내용
Media Tek (대만)	- 스마트폰·네트워킹·자동차·커스텀 데이터센터 ASIC까지 아우르는 대만 팹리스 반도체 기업 - 데이터센터 솔루션을 중심으로 커스텀 반도체 설계 기술 및 랙 수준의 시스템 통합과 함께, 반도체-광신호 연결 기술인 CPO 및 MicroLED 기반 인터커넥트 기술을 통한 전력 절감 솔루션 제공  

③ Power / Cooling Infrastructure

기업명	주요내용
Vertiv (미국)	■ 데이터센터·통신망용 전력, 열관리, 랙, 모듈형 인프라를 제공하는 글로벌 디지털 인프라 기업 ■ AI 팩토리 아키텍처에 대응하기 위한 고밀도 액체냉각 및 직류 (DC) 전력 토털 솔루션 공개, 인프라 구축 기간을 단축하는 반복 설계 기반의 모듈형 전력 배치 기술 제공
LITEON (대만)	■ 광전자·전원·클라우드 인프라·스마트시티 솔루션을 전개하는 대만 전자기업 ■ 차세대 초고밀도 AI 서버 인프라에 대응하는 고전압 직류 전력 아키텍처 기반의 파워 랙(Power Rack) 및 인랙(In-Rack) 액체냉각 솔루션 공개, 고용량 파워 셀과 CDU의 통합을 통한 효율적인 전력·열관리 솔루션 제공
Delta Electronics (대만)	■ 전원전자, 산업자동화, 인프라, 열관리 분야의 대만 대표 기업 ■ AI 모듈러 데이터센터, 데이터센터 마이크로그리드, 800VDC 고전압 전원장치 및 직접 액체냉각 기술 보유, 전력 변환 효율을 극대화한 파워 셀과 대용량 CDU 제품군을 통해 고밀도 랙 인프라 지원 * 공사 기간을 최대 60% 단축 가능한 AI Modular Data Center 인프라 지원

기업명	주요내용
VTC (Vitalcore Technology) (대만)	■ AI PC 및 데이터센터용 열관리·액체냉각 턴키 솔루션을 제공하는 대만 열관리 업체 ■ 고성능 AI 데이터센터의 고발열 문제를 해결하기 위한 CDU, 고밀도 랙, 매니폴드, 콜드플레이트 등 수냉/액체냉각 전반의 하드웨어 턴키 인프라 솔루션 제공  
YS.TECH (元山科技) (대만)	■ 팬·블로워·열모듈 등 냉각/환기 솔루션을 제공하는 대만 열관리 업체 ■ 고발열 AI 서버 및 고성능 연산 시스템용 커스텀 냉각 부품 공급. 핵심 팬/블로워 기술 및 열모듈 설계를 기반으로 하는 다중 응용 고열관리 솔루션 제공  
Molex (미국)	■ 커넥터·인터커넥트·전력·광통신 솔루션을 공급하는 글로벌 연결 솔루션 기업 ■ 차세대 AI 데이터센터 규격에 대응하는 액체냉각 부스바(Liquid Cooled Busbar) 기술과 초고속 고밀도 인터커넥트 솔루션 제공 * 다채널 냉각 경로 설계를 통해 전력 배전 효율 향상과 전력 밀도 증가에 따른 발열을 억제. 단일 채널 대비 최대 20% 냉각 효율 향상 가능  

기업명	주요내용
EA-HWA (대만)	- 서버랙, 19인치 네트워크 캐비닛, OCP 오픈랙 등을 제조하는 대만 랙 인프라 업체 - 오픈 컴퓨트 프로젝트(OCP) 표준 규격 기반의 초고밀도 AI/HPC 전용 오픈랙(ORv3) 인프라 제공. 고전압 버스바 장착 및 공랭, 액체냉각(Liquid-to-Air, D2C) 시스템 지원으로 내진 안정성 강화
DOW (미국)	- 첨단 소재·화학 솔루션을 공급하는 글로벌 소재기업으로 AI 시대 열관리 소재를 적극 확장 중 - 데이터센터 액체냉각 및 침지냉각(Immersion Cooling) 시스템을 위한 전용 플루이드 기술과, 차세대 초고속 광트랜시버 및 패키징 공정에 필수적인 고성능 열계면소재(TIM) 제품군 제공
KAORI THERMAL (대만)	- 데이터센터용 액체냉각 솔루션과 OEM/DFM 서비스를 제공하는 대만 열관리 기업 - CAI 서버 랙 인프라의 핵심인 CDU(냉각분배장치), 침지냉각 탱크(Immersion Tank), 파이프라인 네트워크 및 중앙 집중식 온도 제어 시스템 등 종합 액체냉각 시스템 설계 및 OEM/DFM 엔지니어링 제공

④ Storage / Memory / Data Layer

기업명	주요내용
PASCARI (대만)	- Phison Electronics(대만)가 전개하는 엔터프라이즈 SSD 브랜드로, AI·클라우드·하이퍼스케일 스토리지 제공 - 대규모 AI 데이터 세트 및 하이퍼스케일 환경 처리를 위한 고성능 엔터프라이즈 PCIe Gen5 NVMe SSD 라인업 공개. 고용량 스토리지 및 액체냉각 대응 설계 기술 제시 
PROMISE Technology (대만)	- 기업용 스토리지와 AI·감시·미디어용 고성능 저장장치를 개발하는 대만 스토리지 전문기업 - AI 연산 데이터 가속을 위한 스토리지 플랫폼과 All-Flash 어레이 솔루션 공개. 고대역폭 네트워크 환경을 위한 RDMA/RoCE 및 차세대 인텔 아키텍처 기반의 대용량 고속 데이터 레이어 인프라 제공 

□ 시사점

- 에이전틱·물리적 AI 확산에 따라 AIDC의 핵심 경쟁력이 ‘단품 칩’에서 ‘초고속 연결성(Connectivity)’과 ‘인프라 통합 관리’로 진화함
- 전력 과부하와 데이터 병목 해결을 위한 ‘하이브리드 AI(분산 연산)’, ‘CPO*/초고속 스위치’, ‘800V DC 고전압 및 직접 액체냉각(DLC)’ 기술이 AIDC 성능을 결정하는 핵심 표준으로 부상

* CPO(Co-Packaged Optics, 공동 패키지 광학) : 데이터센터의 전기 신호를 빛으로 전환하여 초고속으로 데이터를 전송하는 기술, 데이터 병목과 전력 소모 문제 해결 핵심 인프라

- AIDC 산업 트렌드에 대응하여 글로벌 표준 기반의 차세대 부품·소재 국산화 개발 및 실증 지원을 통한 글로벌 공급망 진입 가속화 필요
- 글로벌 표준에 부합하는 고효율 전력 배전 및 차세대 액체냉각 (DLC) 국산 부품·소재의 AIDC 테스트베드 구축 및 실증 지원
- 국내 실증 레퍼런스를 확보한 우수 기업 대상 상용화·사업화를 촉진하고, 글로벌 공급망 연계를 위한 해외진출 지원 정책 추진

3 참가기업 회의

□ 딥엑스(DEEPX)

- (일시) 2026. 6. 2.(화) 16:00~18:00
- (장소) TWTC (Taipei World Trade Center Hall 1)
- (참석자) NIPA 정은주 수석, 손예지 책임, 딥엑스 김녹원 대표이사, 박영섭 이사 등 4명
- (주요내용) 기업 소개, 해외진출 현황 공유 및 애로사항 등 논의

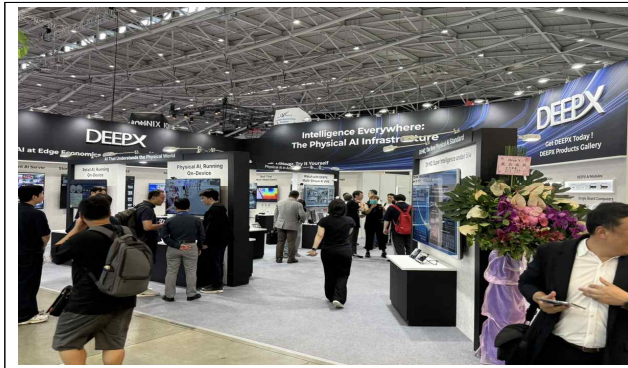
< 회의 주요내용 >

■ UAE 시장 진출 애로사항

- (시장 불확실성 및 세일즈 파이프라인 부재) 한국·미국·중국과 달리 UAE 등 중동은 현지 네트워킹(라포 형성)에 최소 1년 이상 소요되며 기술적 이해도가 낮아 현지 솔루션 논의 대상 및 시장 분석이 모호한 경향 있음
- (리스크 회피 성향) 중동은 막대한 자본을 바탕으로 확실한 결과물을 원하며, 검증되지 않은 초기 기술의 테스트베드가 되는 것을 기피하고 타국 성공 레퍼런스를 선호함

■ 중동 등 해외진출 관련 정부 지원 요청사항

- (철저한 현지 수요 기반 진출) 정부가 타깃 분야를 선정하고 UAE 등 중동 현지 핵심 B2B 기업과의 온라인 미팅 등 파트너십 매칭(수요 파악)을 주도해 줄 것을 요청
- (국가별 맞춤형 턴키(Turn-key) 컨소시엄 구성) 정부·비정부 니즈별로 진출 분야를 세분화하고, AI 풀스택 버티컬 컨소시엄을 구성해 수요국에 제안하는 전략 필요 (딥엑스는 중립적 칩 벤더로서 컨소시엄 참여 의향 적극 피력)
- (G2G/B2B 협력 확대) 해외 투자청(UAE 투자청, Mubadala) 등 정부 기관을 비롯하여 실제 기술을 구매할 현지 대형 B2B 기업들의 초청/연계가 강화되어야 함
- (글로벌 RFI 플랫폼 구축) 향후 우리 기업들이 해외 국가 사업 입찰 정보(RFI/RFP)를 조기에 확보하고 지원할 수 있도록 정부가 채널 역할을 해줄 것을 제안



딥엑스 부스



딥엑스 미팅

□ 래블업(Lablup)

- (일시) 2026. 6. 4.(목) 11:00~13:00
- (장소) TWTC (Taipei World Trade Center Hall 1)
- (참석자) NIPA 정은주 수석, 손예지 책임, 래블업 심민석 Sales Associate, 박주희 Sales Account, 황지원 CFO 등 5명
- (주요내용) 기업 소개, 해외진출 현황 공유 및 애로사항 등 논의

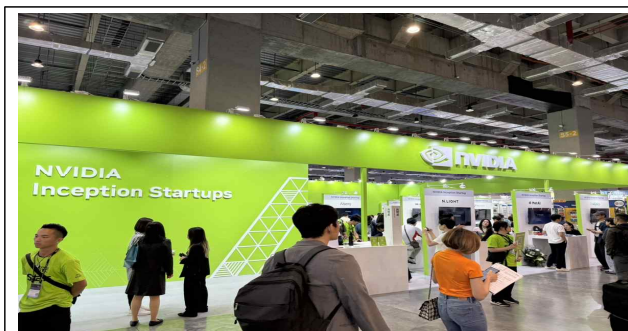
< 회의 주요내용 >

■ 중동 시장 인식 및 진출 전략

- (타깃 집중형 밀도 있는 진출 필요) 스타트업 특성상 리소스가 부족하고 중동 AI 시장 자체가 타 권역 대비 아직 크지 않으므로, 불특정 다수 공략보다 확실한 수요처를 타깃으로 한 밀도 있는 접근이 유효함
- (B2B 기회 발굴 최우선) 당장의 투자 유치보다는 실질적인 비즈니스 기회 및 레퍼런스를 생성할 수 있는 작은 기회라도 발굴하는 것이 시급
- (국가별 전략 차별화) UAE는 당사 투자 유치에 관심 표명, 당사는 싱가포르 및 아태 (APAC) 지역은 지사 인프라 활용, 대만은 현지 하드웨어 파트너 발굴 중

■ 협력 모델 제안

- (HW-SW 동반 진출 필요성) 래블업은 AI 소프트웨어(플랫폼) 기업이므로, 하드웨어 (서버·칩 등) 인프라 기업과 패키지 형태로 연계하여 동반 진출하는 모델이 필수적



엔비디아 파트너 스타트업 부스



래블업 미팅

구분	내용
행사명	· COMPUTEX TAIPEI 2026 (제46회) ※ 1981년 창설, 아시아 최대·세계 3대 ICT 박람회
행사개요	· 글로벌 ICT·AI 산업 핵심 트렌드를 전시·논의하는 세계 최대 규모의 AI·스타트업 박람회 - AI 반도체, GPU, 로봇틱스, 차세대 컴퓨팅 분야 신제품·솔루션 발표 - 대만 ICT 공급망 거점(R&D-제조-응용) 중심으로 기술 생태계 전시
개최기간	· 2026. 6. 2.(화) ~ 6. 5.(금), 4일간
개최장소	· 대만 타이베이市 (난강·신이 지구 연계 4개 전시장 동시 개최) - TaiNEX 1·2(Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1·2) : 메인 전시장 - TWTC(Taipei World Trade Center Hall 1) : 로봇틱스·체험존 - TICC(Taipei International Convention Center) : 컨퍼런스·키노트
행사주최	· 대만대외무역발전협회(TAITRA) · 타이페이컴퓨터협회(TCA) 공동주최 * TAITRA : 1970년 설립, 대만 정부·산업계 후원 비영리 무역진흥기관
대 주 제	· "AI Together" 3대 핵심 주제(Three Cores) ① AI & Computing (AI·컴퓨팅 인프라) ② Robotics & Mobility (로봇틱스·모빌리티) ③ Next-Gen Tech (차세대 기술)
행사규모	· (26년 공식기준) 1,500개 기업(33개국) / 6,000개 부스 · (주요 참가기업) NMDIA, Intel, Qualcomm, MediaTek, AMD, ASUS, Acer, MSI, GIGABYTE, ASRock, Foxconn, Pegatron, Delta, BenQ, KIOXIA, Vertiv, Samsung, Realtek, Advantech, ADATA, ITRI, MITAC, Transcend, Innodisk, Wistron 등 · (참가국) 미국·한국·일본·독일·프랑스·영국·이스라엘·인도·UAE·싱가포르 등 33개국 ※ ('25년 실적) 참관객 86,000여 명(152개국), 글로벌 바이어 40,000명+ 방문
주요내용	① AI & Computing : AI Factory, Agentic AI, Inference 등 ② Robotics & Mobility : AI 로봇·머신비전·임베디드, Smart Mobility & Drone Tech 등 ③ Next-Gen Tech : TechXperience Zone, ePaper Pavilion, Gaming, Advanced Power Tech 등 ④ COMPUTEX Forum : AI 컴퓨팅 아키텍처, 클라우드-엣지, 엔터프라이즈 도입, AI 거버넌스 등 ⑤ 스타트업·부대행사 : InnoVEX(스타트업·VC·국가관), Procurement Meetings (바이어 매칭), ESG GO Initiative, Guided Tour 등